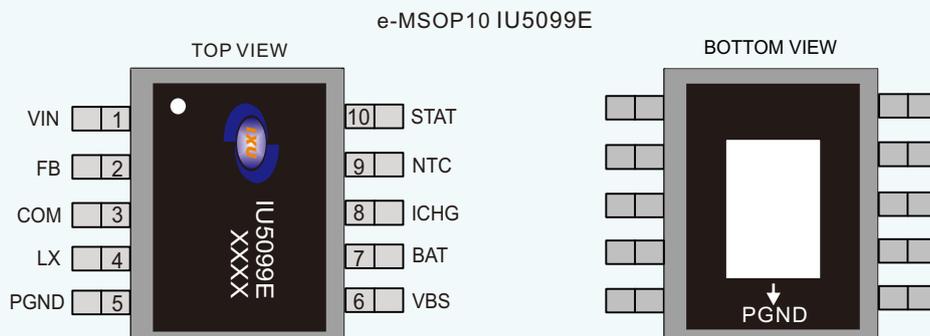
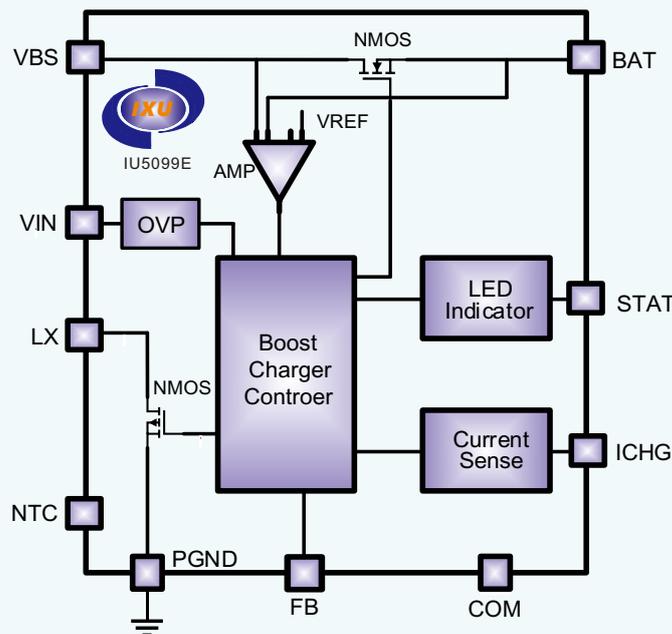


引脚排列以及定义



管脚编号	说明	输入/输出	功能
1	VIN	电源	输入电源
2	FB	输入	电池电压反馈端
3	COM	输出	电池电压检测电阻和芯片内部开关管连接端
4	LX	输入	开关节点, 电感连接端
5	PGND	地	功率地
6	VBS	输出	升压输出端
7	BAT	电源	电池连接端
8	ICHG	输入	充电电流控制端口, 通过与地连接的电阻控制充电电流大小
9	NTC	输出	热敏电阻输入端, 通过外接热敏电阻检测电池温度。可复用为使能端口。
10	STAT	输出	充电状态指示端口, 输出 0 或高阻态
Thermal PAD	PGND	地	功率地

功能框图



极限参数表¹

参数	描述	数值	单位
V _{MAX}	VIN, BAT, LX, VBS, STAT, NTC, FB, COM	-0.3~30	V
	ICHG	-0.3~6	V
T _J	结工作温度范围	-40~150	°C
T _{STG}	存储温度范围	-55~150	°C
T _{SDR}	引脚温度 (焊接 10s)	260	°C

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
VIN	输入电源电压	3.6~6	V
T _J	结工作温度范围	-40~125	°C
T _A	环境温度范围	-40~85	°C

热效应信息²

参数	描述	数值	单位
θ _{JA}	封装热阻 - 芯片到环境热阻	40	°C/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标示	包装尺寸	卷带宽度	数量
IU5099E	e-MSOP10		13"	12mm	5000 units

ESD范围

HBM(人体静电模式) ----- ±2kV

MM(机器静电模式) ----- ±200V

- 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
- PCB板放置IU5099E的地方，需要有散热设计，使得IU5099E底部的散热片和PCB板的散热区域相连。



电气参数：（除特殊说明外，VIN=5V，R_{ICHG}=1KΩ，L=4.7uH）

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{IN}	VIN 端电源电压		3.6	5	6	V
V _{IN_OVP}	VIN 端过压保护阈值	VIN Rising		6		V
ΔV _{IN_OVP}	VIN 端过压保护滞回			200		mV
I _Q	VIN 端芯片静态工作电流			0.6		mA
I _{SD}	VIN 端芯片关断电流	V _{NTC} =0		200		μA
I _{BAT}	电池端电池泄漏电流	不插充电器 or V _{NTC} =0		5		μA
		插充电器, R _{FB1} =1.2MΩ, R _{FB2} =200KΩ		25		
V _{FB}	反馈电压调制阈值		1.188	1.2	1.212	V
V _{CV}	充电浮充电压	K=1+R _{B1} /R _{B2}		K*V _{FB}		V
V _{RCH}	重充电压阈值	V _{BAT} Falling		0.98V _{CV}		V
V _{TRK}	涓流转恒流电压阈值	V _{BAT} Rising		0.67V _{CV}		V
V _{SHORT}	电池短路电压阈值	V _{BAT} Falling		0.17V _{CV}		V
V _{OVPB}	BAT 端过压保护电压	V _{BAT} Rising		1.1V _{CV}		V
I _{CC}	恒流模式充电电流	R _{ICHG} =1KΩ	0.9	1	1.1	A
I _{TC}	涓流模式充电电流			10%		I _{CC}
I _{BS}	短路模式充电电流			10%		I _{CC}
I _{BF}	充电终止电流			10%		I _{CC}
f _{SW}	开关频率			500		KHz
A _I	电流放大倍数	A _I =I _{CC} /I _{ICHG}		1000		
I _{NTC}	NTC 端口输出电流		18	20	22	μA
V _{NTCL}	NTC 端低温保护阈值			1.31		V
V _{NTCH}	NTC 端高温保护阈值			0.4		V



电气参数: (除特殊说明外, $V_{IN}=5V$, $R_{ICHG}=1K\Omega$, $L=4.7\mu H$)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
TMR_{TC}	TC 阶段充电时间限制			9.5		Hour
$TMR_{CC/CV}$	CC/CV 阶段充电时间限制			15.5		Hour
T_{REG}	芯片热调节阈值			120		°C
T_{SD}	芯片热保护温度			150		°C
ΔT	芯片热保护温度滞回			20		°C

IU5099E应用要点

1. 充电过程

IU5099E采用完整的CC/CV充电模式。当电池电压小于所设定的涓流点时，系统以涓流电流对电池充电。当电池电压大于所设定的涓流点时，系统进入恒流充电模式。当电池电压接近所设定的浮充电压时，系统进入恒压模式。当系统进入恒压模式后，如果充电电流小于终止充电电流，系统会停止充电，表示电池已经充满。如果电池电压之后又跌落至重启电压以下，系统会重新开启给电池充电。这里所谓的充电电流 I_{CC} ，指的是从芯片BAT端口流出来到电池正极的电流值。

2. 保护功能

IU5099E具有完善的电池充电保护功能。当芯片出现输入端过压，输出端过压和芯片过温状态，升压充电功能会立即关闭。当电池电压低于 V_{SHORT} ，输出欠压保护功能开启，主功率管首先关闭，Block管会进入线性模式，并以较小的短路模式充电电流给电池充电；当电池电压高于 V_{SHORT} ，输出短路保护功能关闭。

3. 输入电流自适应功能

IU5099E内置特殊的环路，可以自动调节充电电流的大小，从而避免输入直流电源进入过驱动状态。因为大的充电电流会导致输入电源电压的下降，随着电源电压的下降，内部自适应环路运放的输入端也随之下降。当降低到内部基准值时，内置的自适应环路就会自动调节系统占空比，减小充电电流的大小和输入电源的驱动压力，从而使输入电压被固定在4.235V左右。

4. 芯片温度自适应调节功能

IU5099E内置温度调节环路，当芯片处于恒流充电过程时如果温度升高至120°C时温度控制环路开始起作用，充电电流开始逐渐降低，芯片温度会随之下降，最终芯片温度会稳定在设定值，从而起到保护芯片的作用。

5. 充电LED指示

芯片的STAT状态脚，输出0电平或者高阻态。如果不接LED灯，而是直接与主控相连，须有一个上拉电阻把高阻态转化成确切的高电平。

- 充电过程常亮，充满后灭掉。
- 当出现电池端过压、电池短路、充电时间超时、芯片过温、NTC端口检测到电池温度异常、输入过压等情况时，以1.6Hz的频率闪烁。

IU5099E PCB 注意事项

我司DEMO所示PCB只是芯片应用中的其中一例，不代表客户一定完全按照上图来布局自己的产品。请根据实际所用元器件和产品需求进行布局布线。但右图所示的布局原则以及最需要注意的事项，对于每个产品都有其通用性。

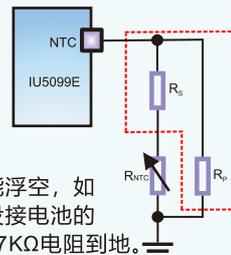
- 电感走线应尽可能的宽，并单独走线为芯片供电。
- BOOST模块主要的电流回路走线应该短而粗。
- LX走线尽量短，同时其尽量不要覆盖多余面积，以优化EMI。
- 电感和肖特基二极管应直接相连，连线短而粗，避免过孔跳线。
- 电源端的电容应尽可能的靠近芯片管脚放置。
- 芯片底部散热片是功率地，应与大片的地相连，并且保证其可靠地焊接。

6. NTC电阻设定

IU5099E在电池充电时支持NTC保护功能，通过NTC引脚检测电池温度的高低。当检测温度超过设定的温度窗口值时，系统会停止充电。

NTC保护功能工作方式为：NTC管脚外接电阻网络到GND，从NTC管脚输出恒定20 μ A

电流，通过该电流在电阻网络上产生的压降来判断电池的温度范围，其温度过低内部判断点为1.31V，温度过高内部判断点为0.4V。如图所示，可以用 R_s 和 R_c 组成的电阻网络，配合合适的NTC电阻进行设计。NTC管脚不能浮空，如果不用NTC功能或者生产测试时没接电池的NTC电阻时，该管脚必须接总共47K Ω 电阻到地。

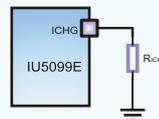


7. 使能功能

NTC管脚可以复用为芯片使能管脚。当NTC管脚电压接零电平（最高不超过0.2V）时，禁止芯片充电，STAT管脚同时输出高阻态。

8. ICHG 端电阻的计算

ICHG端电阻的值反映充电电流的大小，根据不同的应用场合可以方便的通过调节ICHG端电阻 R_{ICHG} 的阻值（ R_{ICHG} 必须小于2K Ω ）来确定充电电流的大小，具体电路如下图所示：

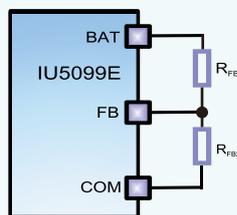


恒流充电阶段充电电流的大小 I_{CC} 和 R_{ICHG} 的关系通过以下公式确定：

$$I_{CC} = \frac{1 * 1000}{R_{ICHG}}$$

9. 电池浮充电电压设定

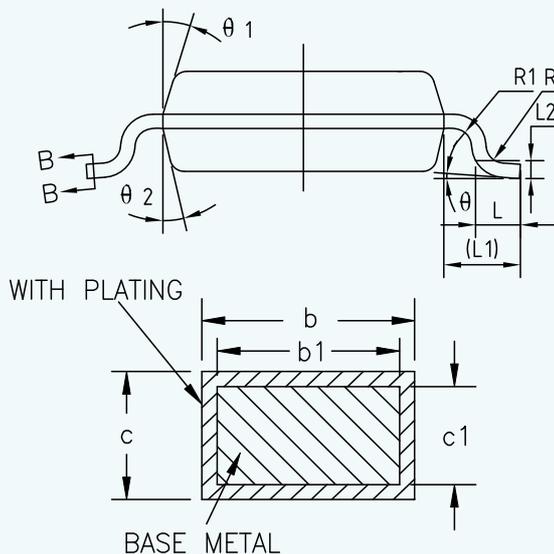
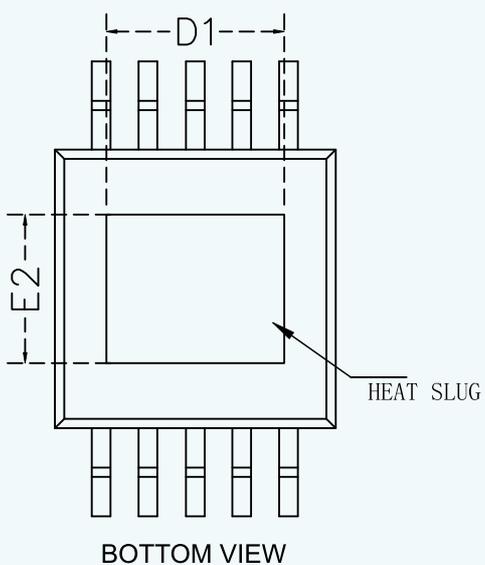
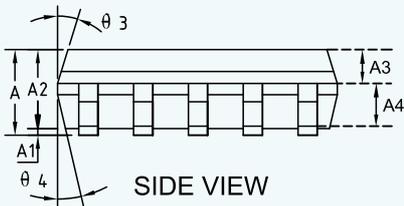
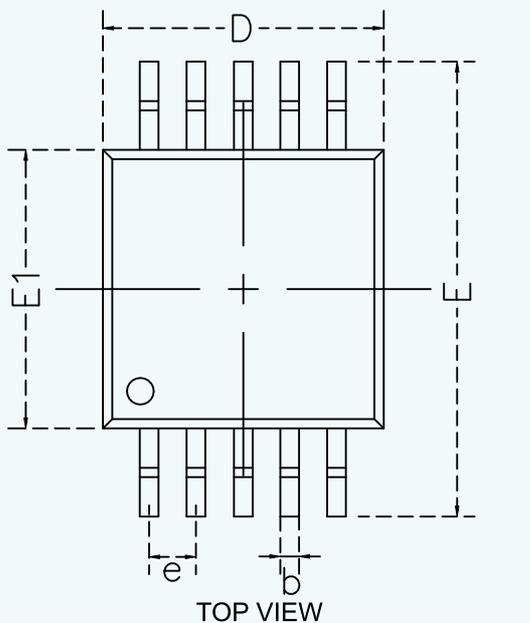
芯片FB管脚对应的内部钳位电压阈值为1.2V，根据该电压和外部两个分压电阻 R_{FB1} 和 R_{FB2} ，即可设定电池充电的浮充电电压值，具体公式如下所示：



$$V_{CV} = \frac{1.2 * (R_{FB1} + R_{FB2})}{R_{FB2}}$$

封装信息

IU5099E e-MSOP10 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS (units:mm)

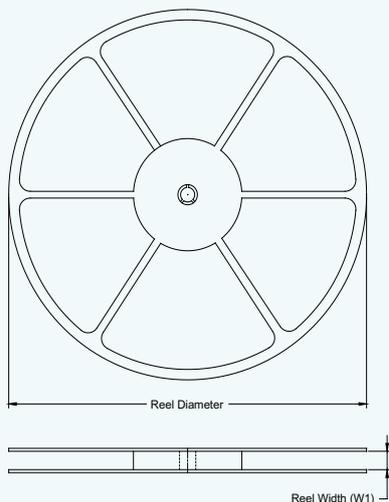


SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.75	-	1.10
A1	0	-	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
A3	0.25	0.35	0.39
A4	0.346	-	0.510
b	0.18	0.225	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.154	0.177	0.20
c1	0.144	0.152	0.16
D	2.80	3.00	3.20
e	0.40	0.50	0.60
E	4.70	4.90	5.10
E1	2.80	3.00	3.20
D1	1.85	1.90	1.95
E2	1.55	1.60	1.65
L	0.40	0.60	0.80
L1	0.95REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	--	--
R1	0.07	--	--
theta	0°	--	8°
theta 1	9°	12°	15°
theta 2	9°	12°	15°
theta 3	9°	12°	15°
theta 4	9°	12°	15°

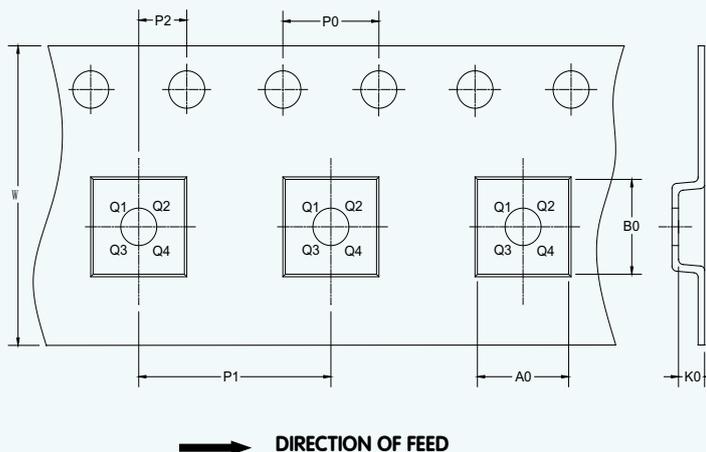
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-137E
2. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH
3. DIMENSION E1 DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH
4. FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25mm PER SIDE.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS



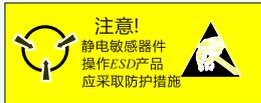
TAPE DIMENSIONS



NOTE: The picture is only for reference. Please make the object as the standard.

KEY PARAMETER LIST OF TAPE AND REEL

Package Type	Reel Diameter	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
e-MSOP-10 (Exposed Pad)	13"	12	5.20	3.30	1.50	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1



MOS电路操作注意事项:

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明:

- 上海埃诚攸微电子有限公司保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在使用前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用上海埃诚攸微电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品品质的提升永无止境,上海埃诚攸微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!